

芯片封装导电银胶

产品名称	芯片封装导电银胶
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

产品详情

一、银胶的优势

1. 导热性好：银胶具有良好的导热性能，能够有效地将芯片产生的热量导出，避免芯片过热导致性能下降或损坏。
2. 耐高温：银胶能够承受较高的温度，不易变形或失效，保证了芯片封装的稳定性。
3. 抗氧化：银胶具有较好的抗氧化性能，不易被氧化腐蚀，延长了使用寿命。

二、用途

银胶在芯片封装中主要用于导热填充和密封。通过将银胶涂覆在芯片和散热器之间，能够有效地将芯片产生的热量导出，同时防止空气中的水分和有害物质进入芯片内部，保证其稳定运行。